技术创新需求调查表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位信息** | | | | | | |
| 单位名称 | | | | 南充三环电子电子有限公司 | 社会统一信用代码 | 915113036879318633 |
| 联系人 | | | | 黄明 | 联系电话 | 18881762377 |
| 行政区域 | | | | 四川省（自治区、直辖市）南充市（地）市（县） | | |
| 是否在国家高新区内？ | | | | □是 （高新区名称）  ■否 | | |
| 所属行业 | | | | 制造业 | 技术领域 | 新材料 |
| 上一年度  营业总收入 | | | | 53600（万元） | 人员总数 | 3600（人） |
| 高新技术企业认定 | | | | ■是□否 | 科技型中小企业备案 | □是■否 |
| 需求名称 | | 特种氧化铝陶瓷基板技术 | | | | |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术）  □产品研发（产品升级、新产品研发）  □技术改造（设备、研发生产条件）  □技术配套（技术、产品等配套合作） | | | | |
| 需求  内容 | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）  南充三环电子电子有限公司是南充市高坪区重点企业，位于高坪区工业园区内，主营电子产品，生产电子行业各类产品联接件，现对铜板用高性能氧化铝陶瓷基板的开发、生产技术提出需求，研究高抗折、高硬度的特种氧化铝功能陶瓷配方，研究生产制程中精密冲压、高温成瓷及抚平、精密激光加工等产业化核心关键技术，获得高精密、高强度的特种氧化铝陶瓷基板。主要技术指标  体积密度：≥3.7g/cm3；  抗折强度：≥300MPa；  维氏硬度：≥14GPa；  线膨胀系数（20-500℃）：(6.0-7.5)×10-6/℃；  体积电导率(20℃)：≥1014Ω•cm；  击穿强度：≥15kV/mm。 | | | | |
| 现有  基础 | （已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等）  公司目前已建立陶瓷基体部件生产基地，于2010 年建成投产，形成年产1500 亿只以上的白瓷体的生产规模，占世界年产量的55%以上；建立光纤连接器部件生产基地，于2011 年建成投产，形成年产18 亿只的生产规模，产销量占全球近75%，市场占有率居全球前列；建成陶瓷基板生产基地，形成年产7.2亿片陶瓷基板的生产规模。 | | | | |
| 产学研合作要求 | 简要  描述 | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）  从事高性能陶瓷材料研发领域的高校、科研院所，要求专家及其团队研发实力雄厚，所属机构具有先进的检查分析设备。 | | | | |
| 合作  方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 □委托研发  ■委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 | | | | |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 ■知识产权 □科技金融  ■检验检测 □质量体系 ■行业政策 ■科技政策 □招标采购  ■产品/服务市场占有率分析 ■市场前景分析 ■企业发展战略咨询 □其他 | | | | | |
| **管理信息** | | | | | | |
| 同意公开  需求信息 | | | ■是 □否  □部分公开（说明） | | | |
| 同意接受  专家服务 | | | ■是  □否 | | | |
| 同意参与解决方案筛选评价 | | | ■是  □否 | | | |
| 同意出资奖励优秀解决方案 | | | □是，金额万元。（奖金仅用作鼓励挑战者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）  ■否  法人代表： 2019年7月21日 | | | |